

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年5月25日(25.05.2023)



(10) 国際公開番号

WO 2023/090348 A1

- (51) 国際特許分類:
C08G 73/10 (2006.01) C08L 79/08 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2022/042511
- (22) 国際出願日: 2022年11月16日(16.11.2022)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2021-189349 2021年11月22日(22.11.2021) JP
- (71) 出願人: 日本化薬株式会社(NIPPON KAYAKU KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒1000005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 西村 謙吾 (NISHIMURA Kengo); 〒1158588 東京都北区志茂三丁目3番12号 日本化薬株式会社内 Tokyo (JP). 田中 竜太郎(TANAKA Ryutaro); 〒1158588 東京都北区志茂三丁目3番12号 日本化薬株式会社内 Tokyo (JP). 山本 和義(YAMAMOTO Kazuyoshi); 〒1158588 東京都北区志茂三丁目3番12号 日本化薬株式会社内 Tokyo (JP). 佐々木 智江(SASAKI Chie); 〒1158588 東京都北区志茂三丁目3番12号 日本化薬株式会社内 Tokyo (JP). 長嶋 憲幸(NAGASHIMA Noriyuki); 〒1158588 東京都北区志茂三丁目3番12号 日本化薬株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 上村 陽一郎(KAMIMURA, Yoichiro); 〒1030014 東京都中央区日本橋蛸殻町1-13-7 日本橋人形町プレイス7階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(54) Title: POLYIMIDE RESIN, RESIN COMPOSITION CONTAINING SAID POLYIMIDE RESIN, AND CURED PRODUCT THEREOF

(54) 発明の名称: ポリイミド樹脂、該ポリイミド樹脂を含有する樹脂組成物及びその硬化物

(57) Abstract: The purpose of the present invention is to provide: a resin material that has a novel structure and that can be suitably used in a printed wiring board; and a resin composition which contains this resin material and which yields a cured product having excellent heat resistance, dielectric properties, and adhesion to a metal foil or a substrate having low roughness. In order to achieve the foregoing, a polyimide resin is used, the polyimide resin being a copolymer of: an amino compound (A) containing a straight chain aliphatic diamino compound (a1), which has an amino group at both terminals, 1-4 methyl groups and/or ethyl groups in the side chains and 17-24 carbon atoms in the main chain, and an aromatic diamino compound (a2); and a tetrabasic acid dianhydride (B).

(57) 要約: プリント配線板に好適に用い得る新規構造の樹脂材料、及び該樹脂材料を含有し、基材への塗工性に優れると共に、その硬化物は粗度の低い金属箔並びに基材に対する接着性、耐熱性及び誘電特性に優れる樹脂組成物を提供することを目的とする。両末端にアミノ基を有し、かつ側鎖にメチル基及び／又はエチル基を1乃至4個有し、主鎖の炭素数が17乃至24の直鎖脂肪族ジアミノ化合物(a1)と、芳香族ジアミノ化合物(a2)とを含むアミノ化合物(A)及び四塩基酸二無水物(B)の共重合物であるポリイミド樹脂を用いることにより、上記目的を達成することができる。

[続葉有]

WO 2023/090348 A1

添付公開書類：

一 国際調査報告（条約第21条(3)）